

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	兴业证券策略会、华夏基金、中欧基金、招商基金、易方达基金、信达澳亚基金、国同基金、国新投资等。
时间	2023年3月21日-3月22日
地点	策略会举办地（厦门）、无锡深南电路有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司主营业务整体规划布局情况。</p> <p>公司专注于电子互联领域，在不断强化 PCB 业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务，形成业界独特的“3-In-One”业务布局。公司业务覆盖 1 级到 3 级封装产业链环节，具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供一站式综合解决方案。</p> <p>分业务下游领域看，公司 PCB 业务产品下游以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域；电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，公司主要聚焦通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域；封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。</p>

Q2、请介绍公司目前各生产基地业务布局。

公司深圳龙岗基地、无锡基地均涉及印制电路板、电子装联及封装基板三项主营业务，南通基地涉及印制电路板业务，广州基地（在建）涉及封装基板业务。

Q3、公司 PCB 业务 2022 年营收与毛利率的变动原因。

2022 年，公司 PCB 业务营收同比增长 1.01%，业务毛利率同比提升 2.8 个百分点。从营收层面看，2022 年公司 PCB 业务营收增长主要来自海外通信及汽车电子领域，弥补了国内通信领域全年需求放缓、数据中心领域自第三季度以来需求走弱及 EGS 平台服务器芯片发布延期的影响，PCB 业务全年营收规模同比相对保持平稳。从毛利率层面看，公司一方面通过主动优化业务订单结构，提升高盈利产品占比；另一方面通过智能制造、工程设计优化等内部精益改善工作，进一步提高产品质量和工厂运营效率，进而有效促进 PCB 业务毛利率增长。此外，汇率变动、原材料价格回落也对业务毛利率提升有正向作用。

Q4、请介绍公司封装基板业务 2022 年营收与毛利率的变动原因。

2022 年，公司封装基板业务营收同比增长 4.35%，毛利率同比下降 2.1 个百分点。从营收层面看，主要由于 2022 年全球半导体景气逐步走弱，特别自下半年以来全球消费电子市场需求持续回落，对公司部分应用于消费领域的封装基板产品订单需求产生一定影响。同时，公司对存储类产品的客户开发及深耕工作取得显著成效，保障了报告期内封装基板业务稳定的订单来源。封装基板业务全年营收规模微幅增长。从毛利率层面看，受无锡二期基板工厂连线爬坡导致单位固定成本分摊增加，以及下半年以来消费领域需求下行影响，2022 年公司封装基板业务毛利率同比下降。

Q5、请介绍公司电子装联业务 2022 年营收与毛利率的变动原因。

2022 年公司电子装联业务营收同比下降 10.08%，毛利率同比增长 0.6 个百分点，主要由于该业务采用的 Turnkey、Consign 两种销售模式占比变化所影响。此外，公司通过加强精细化管理、升级自动物流与生产自动化等降本增效措施，助益公司电子装联业务毛利率同比增长。

Q6、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。在国内通信市场需求放缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司凭借行业领先的技术实力与高效优质的服务能力，在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场，海外通信业务占比有所提升。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备发展前景。

Q7、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。2022 年，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。2022 年第三季度以来，受 EGS 平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司 PCB 业务数据中心领域短期内承压。

Q8、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。报告期内，伴随公司加大对汽车电子市场开发力度及南通三期工厂连线爬坡，汽车电子订单同比增长超 60%，营收规模同比实现较大增长，但占 PCB 整体营收比重相对较小。目前，汽车电子领域订单保持稳定增长。

Q9、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。

公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看，公司封装基板业务主要面向 IDM 类（半导体垂直整合制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT 类（半导体封测商）厂商。

Q10、请介绍公司目前 FC-BGA 封装基板研发进展。

公司现已具备 FC-BGA 封装基板中阶产品样品制造能力，目前已有部分产品向客户进行送样验证。高阶产品技术研发按期顺利推进。

Q11、请介绍公司是否涉及 6G 通信技术。

通信领域是公司长期深耕的重要下游市场之一，目前行业内 6G 技术研发尚处于探索研究阶段。公司对行业前沿技术保持关注和研究，积极探索行业机会并做好相应技术储备。

Q12、请介绍公司目前整体订单情况。

受消费电子领域需求较弱、数据中心下游去库存等因素影响，当前市场整体需求较为平淡。

Q13、请介绍公司南通三期项目连线后产能爬坡进展。

公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，2022 年底已开始盈利，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到四成以上。

Q14、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。

相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升。

Q15、请介绍公司广州封装基板项目的建设进展。

公司广州封装基板项目共分两期建设，其中项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设。目前项目进展按计划顺利进行，预计将于 2023 年第四季度连线投产。

Q16、请介绍公司近期原材料采购价格变化情况。

受大宗商品及供需关系变化影响，2022 年覆铜板等主要原材料整体价格同比有所下降；化学品价格有所提升，但占原材料比重较小。目前，公司原材料价格整体保持稳定。

	<p>公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>Q17、请介绍公司 2022 年资本开支情况及 2023 年计划。</p> <p>公司 2022 年资本开支主要涉及广州封装基板项目、无锡基板二期项目以及坪西建设工程。2023 年公司资本开支计划继续集中于广州封装基板项目、无锡基板二期、坪西建设工程以及公司三项主营业务持续的技术改造项目等，具体视各项目实际建设进展而定。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 27 日